



企業IR&個人投資家応援イベント

東京エレクトロンデバイス IRセミナー

2024年2月10日（土）

東京エレクトロン デバイス株式会社

代表取締役社長 徳重 敦之

本日の内容

- 会社概要
- 中期経営計画 VISION2025
- 2024年3月期 通期業績見込み
- 株主還元



会社概要

会社概要

設立年月日 1986年3月3日

本社所在地 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-4 横浜イーストスクエア

資本金 24億9千5百万円

売上高 2,403億円（2023年3月期）

従業員数 連結 1,318名（2023年3月31日現在）

拠点・グループ 国内 18拠点、子会社 7社、関連会社 1社



1965年

東京エレクトロン株式会社で電子部品ビジネスを開始

1998年

東京エレクトロン株式会社から 電子部品事業
(現：半導体及び電子デバイス事業) を全て譲受け

2003年

東京証券取引所 市場第2部上場

2006年

東京エレクトロン株式会社から コンピュータネットワーク事業
(現：コンピュータシステム関連事業) を承継

2010年

東京証券取引所 市場第1部上場

2017年

株式会社アバール長崎 (現：東京エレクトロン デバイス長崎株式会社) を連結子会社化

2018年

株式会社ファーストを連結子会社化

2022年

東京証券取引所 プライム市場へ移行

2023年

日本エレクトロセンサデバイス株式会社からウェーハ検査装置事業譲受け



半導体製造装置メーカー
東京エレクトロン

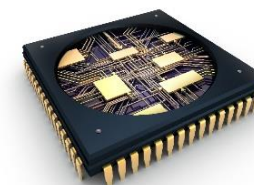
半導体製造装置事業



専門商社
東京エレクトロンデバイス

半導体及び電子デバイス
(EC) 事業

コンピュータシステム関連
(CN) 事業



- EC事業とCN事業が分離・独立
- 東京エレクトロンの出資比率は33.82%
- 東京エレクトロンの持分法適用関連会社

事業内容

最先端の半導体やITシステムなどを提供する **専門商社**
メーカー機能 強化を推進

※セグメント区分では、PB事業はEC事業に含まれております。

CN 事業

コンピュータシステム関連事業



ITインフラ機器



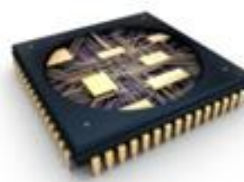
セキュリティソフトウェア



IT保守・監視サービス

EC 事業

半導体及び電子デバイス事業



半導体



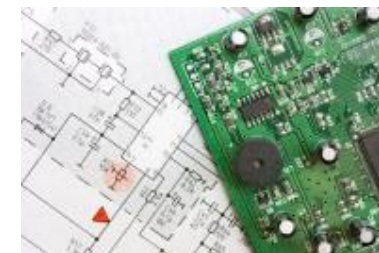
基板（ボード）



クラウドサービス

PB 事業

プライベートブランド事業



設計・量産受託サービス



プライベートブランド製品

商社機能

メーカー機能

東京エレクトロンデバイス

仕入先



海外
ITベンダー



CN 事業

コンピュータシステム関連事業



ITインフラ機器



セキュリティソフトウェア



IT保守・監視サービス

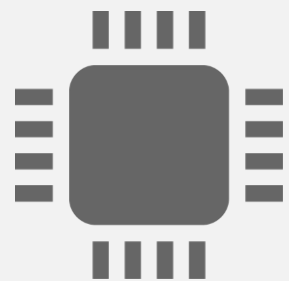


販売先



システム会社
データセンター
官公庁
一般企業

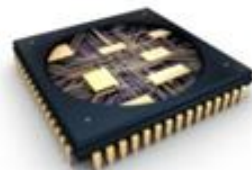
仕入先



海外半導体・
電子部品
メーカー



EC 事業 半導体及び電子デバイス事業



半導体



基板（ボード）



クラウドサービス



販売先



電子機器・
産業機器・
車載機器などの
製造業
（メーカー）

PB 事業 プライベートブランド事業



設計・量産受託
サービス



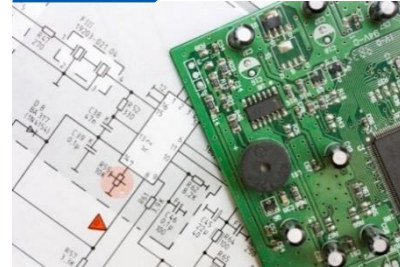
プライベートブランド
製品



エンジニアの技術力を生かした
半導体や基板の開発

設計・量産受託サービス

設計



開発



量産



東京エレクトロンデバイス長崎

製造業の自動化・省人化のニーズに対応した
モノづくりシステムの開発

プライベートブランド製品



化合物半導体ウェーハ検査装置
「RAYSENS」



ビジョンロボットシステム「TriMath」

事業セグメント

CN 事業

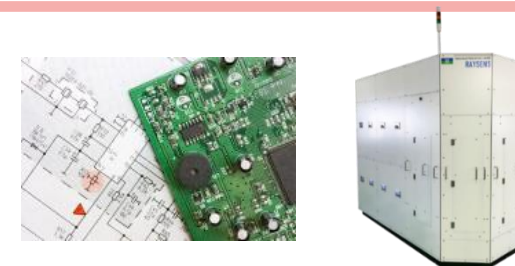
売上高 292億円
セグメント利益 20億円



PB 事業

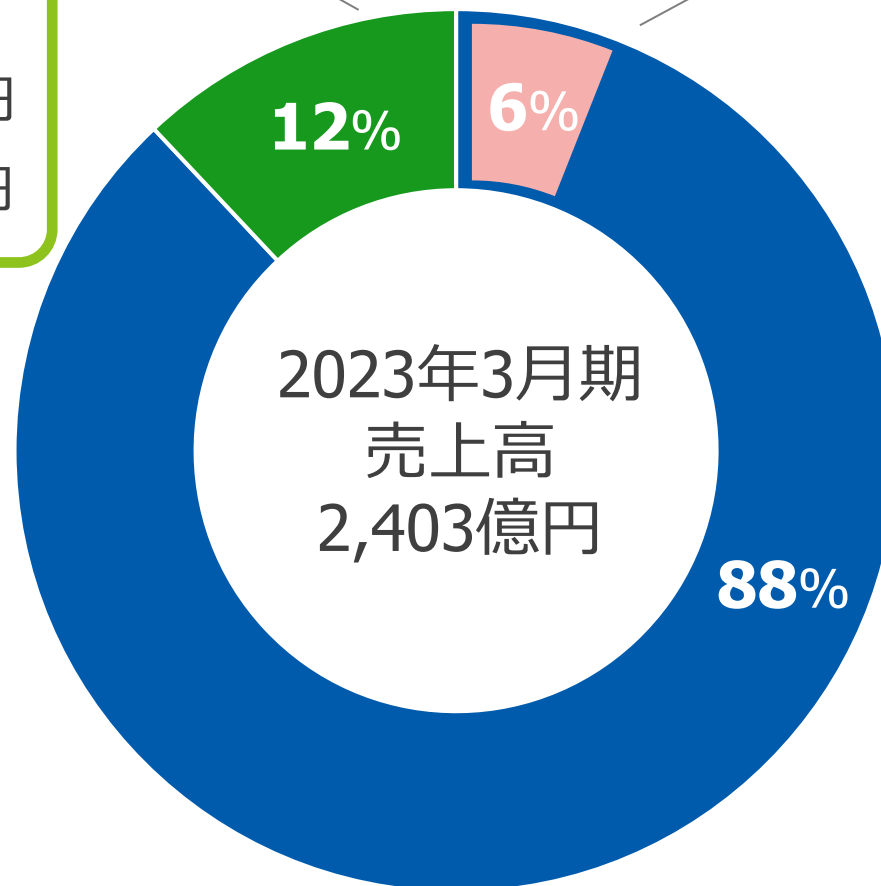
売上高 144億円※

※セグメント区分では、
PB事業はEC事業に含まれております。



EC 事業

売上高 2,110億円
セグメント利益 104億円



当社の製品が使用される分野

CN 事業

コンピュータシステム関連事業

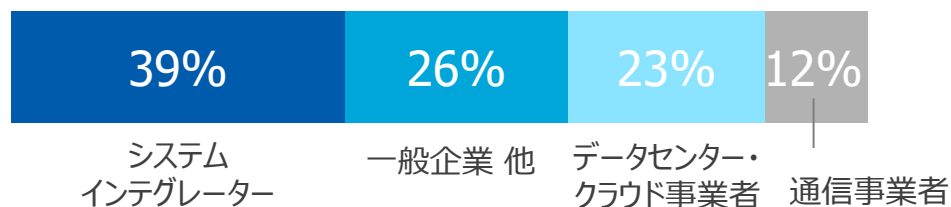
EC 事業

半導体及び電子デバイス事業

PB 事業

プライベートブランド事業

分野別売上高構成比



システムインテグレーター



一般企業

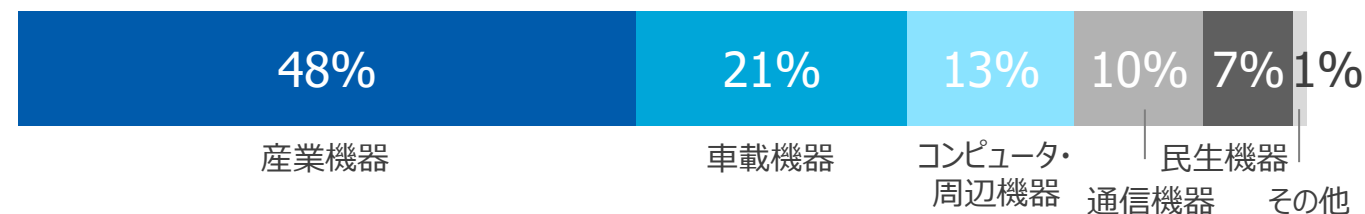


データセンター



通信事業者

用途別売上高構成比



産業機器



車載機器



PC・周辺機器

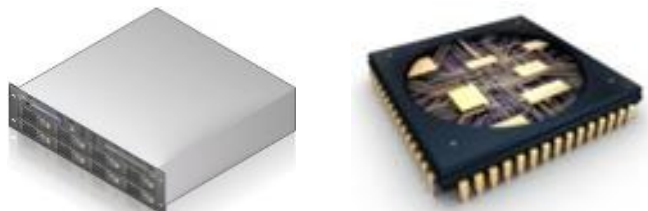


通信機器



民生機器

製品



- シリコンバレー発の
新規性・専門性の高い
IT製品
- **海外有力メーカー**の
半導体製品

顧客



- **幅広い分野**のお客様
- お客様は**大手メーカー**を
含め 2,000社以上

技術



- 製品の**技術サポート**や
保守・監視サービス
- 最先端技術を提供する
技術サービス
- **設計・量産受託サービス**



中期経営計画 VISION2025



<https://www.youtube.com/watch?v=elPOf8GGtmU>



想定する事業環境

Society 5.0 の到来

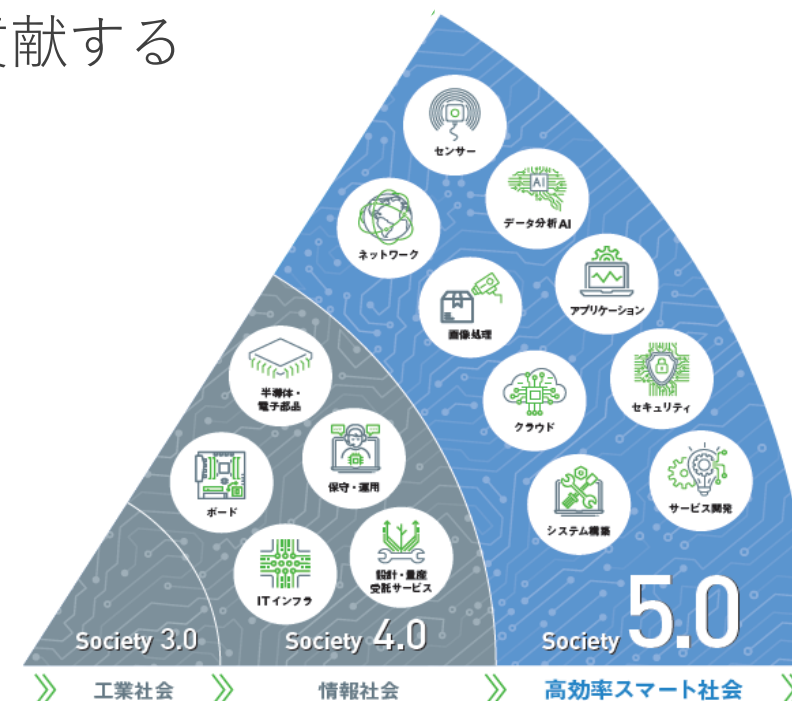
低成長経済下における
高効率スマート社会



当社のMISSION

DRIVING DIGITAL TRANSFORMATION

デジタルトランスフォーメーションを
実現する製品・サービスを提供し
高効率スマート社会の持続的发展に
貢献する



技術商社機能を持つメーカーへ

進化する技術商社機能

- データ・サービス・ストックビジネスを利益源泉とするビジネスモデル
- メーカー事業の成長に資する顧客基盤の維持・拡大
- 安定的な利益基盤の構築

メーカーとして目指す形

- モノづくりシステムメーカー
- ODMメーカー
- 課題解決型の設計開発部門
- 高効率スマート工場

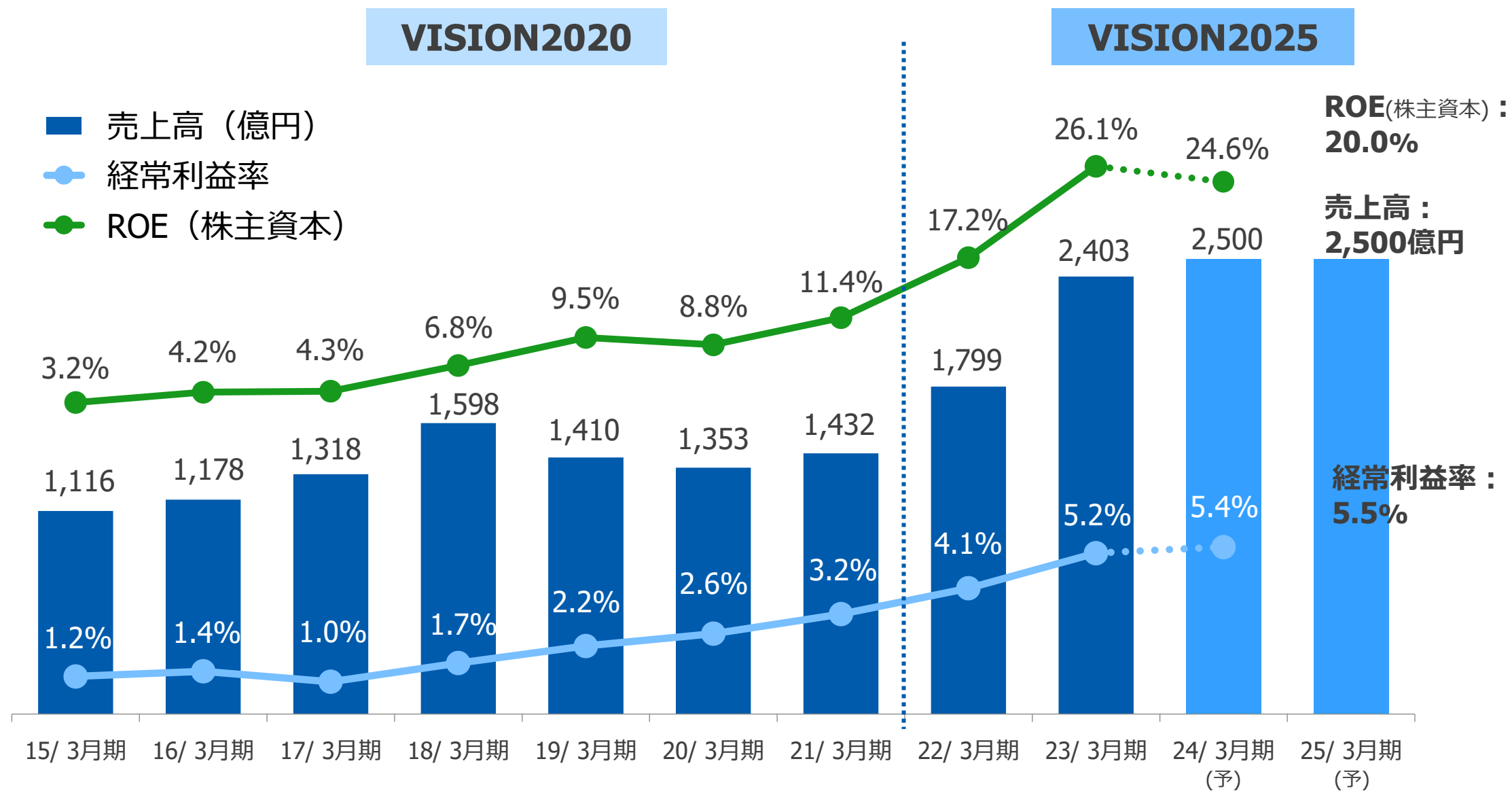
2023年3月期 財務指標を達成

	VISION2025 目標数値 (2025年3月期)	2023年3月期	VISION2025 最新見通し (2025年3月期)
売上高	2,000 億円±10%	2,403 億円	≥ 2,500 億円
経常利益率	> 5.0 %	5.2 %	≥ 5.5 %
ROE (株主資本)	> 15.0 %	26.1 %	≥ 20.0 %

増益増収（増益率＞増収率）による持続的成長を目指す

次期中期経営計画 2024年度中に公表予定

中期経営計画



サービスビジネスの強化

- セキュリティ関連製品 および サービス
- AI 関連サービス（AI評価・検証）
- クラウドサービス

自社サービスを提供する
DXベンダー

メーカー機能の強化

- ODM（医療関連機器）
- モノづくりシステムの海外展開
- ロボットビジョンの高機能化
- 設計・量産受託サービス

プライベートブランド製品を提供する
メーカー

顧客のシステム構築・運用支援する 自社ITサービスの拡大

クラウド

クラウド
インテグレーション
サービス

クラウド導入・
運用支援

ITインフラ

NOC
サービス

24時間365日
ネットワーク
運用・監視

セキュリティ

SOC
サービス

24時間365日
セキュリティ
運用支援



AI

AI
エンジニアリング
サービス

世界最速クラス
AIアクセラレータ利用・
エンジニアサポート



ITインフラ

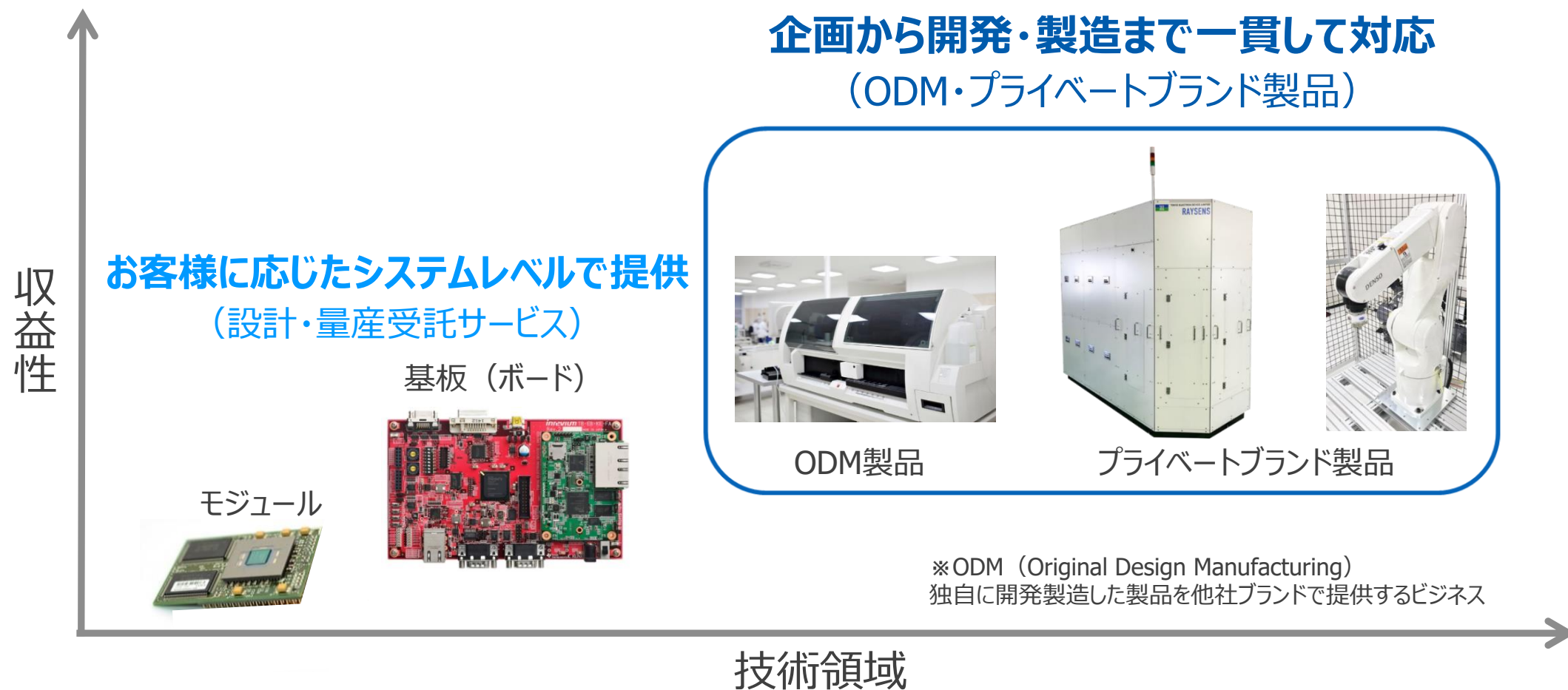
運用保守
DX
プラットフォーム

ITシステム運用
サポート



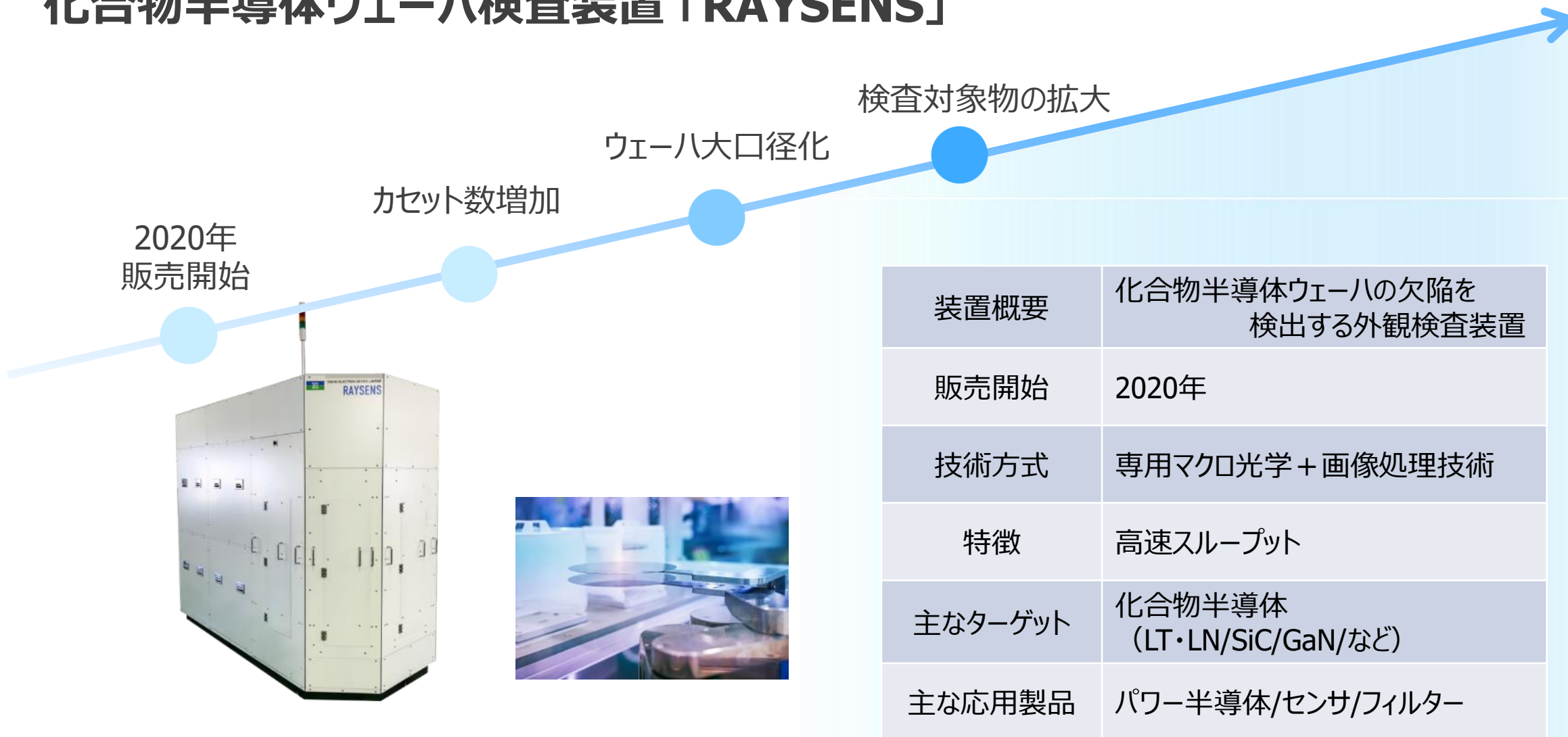
メーカー機能の強化

収益性向上を目指し 技術領域を拡大



メーカー機能の強化（モノづくりシステム）

化合物半導体ウェーハ検査装置「RAYSENS」

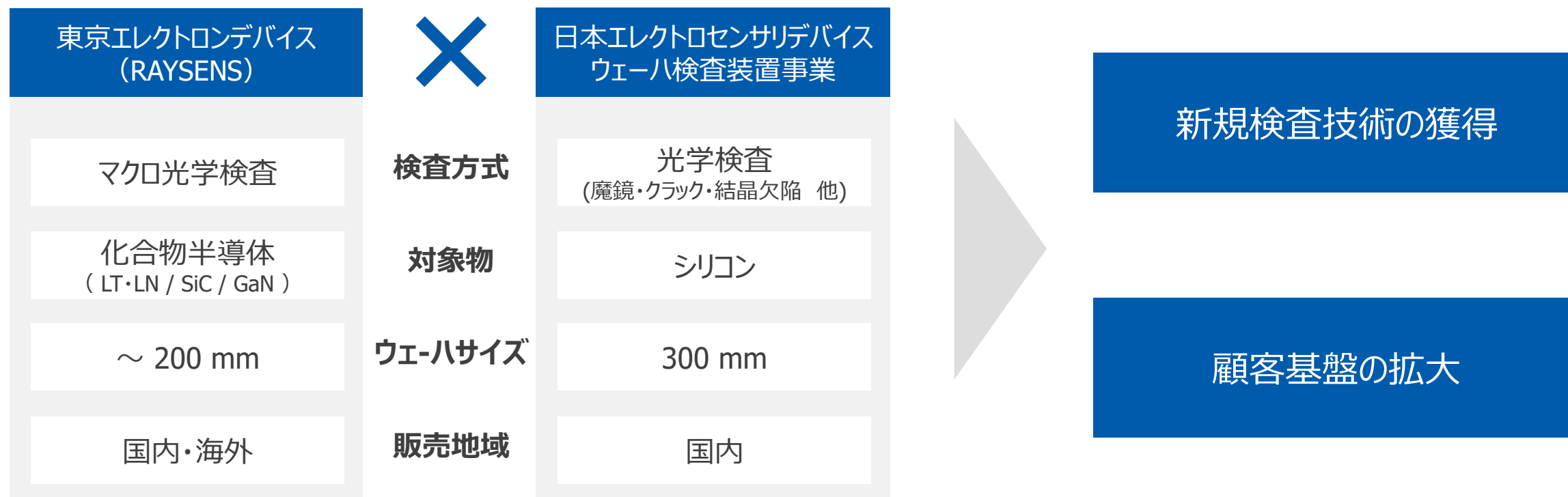


メーカー機能の強化（モノづくりシステム）

事業譲受けによるシナジー効果

得意分野や販売地域において補完関係

新規検査技術の獲得により製品開発期間短縮が可能に 顧客基盤も拡大





2024年3月期 通期業績見込み

2024年3月期 下期 事業計画前提（期初からの変更）

2023年3月期

急伸期

- 半導体市場 好調
- 半導体供給 逼迫 継続
- IT投資堅調
- 為替 円安

売上高 2,403 億円
経常利益率 5.2 %
ROE 26.1 %

2024年3月期

調整期

- 半導体市場 前年比マイナス
→下期から影響が顕在化
- 半導体供給 段階的に正常化
- IT投資堅調
- 為替 前年同水準 →円安水準
- 半導体商権拡大 →円滑に進捗

売上高 2,500 億円
経常利益率 5.4 %
ROE 24.6 %

2025年3月期

成長期

- 半導体市場 幅広い分野で回復
→回復に遅れ
(中国市場の停滞)
- 半導体供給 逼迫 限定的
- IT投資堅調

売上高 ≥ 2,500 億円
経常利益率 ≥ 5.5 %
ROE ≥ 20.0 %

2024年3月期 業績見込み

(百万円)

	2023年3月期	2024年3月期	対前年比		2024年3月期	
	通期	通期予想	増減額	増減率	1-3Q実績	通期予想 進捗率
売上高	240,350	250,000	9,649	4.0%	179,748	71.9%
CN事業	29,255	32,180	2,924	10.0%	20,940	65.1%
EC事業(連結)	211,094	217,820	6,725	3.2%	158,807	72.9%
EC事業	196,595	203,090	6,494	3.3%	148,920	73.3%
PB事業	14,498	14,730	231	1.6%	9,886	67.1%
経常利益 (利益率)	12,478 (5.2%)	13,500 (5.4%)	1,021	8.2%	9,717 (5.4%)	72.0%
当期純利益 (利益率)	8,778 (3.7%)	9,770 (3.9%)	991	11.3%	7,070 (3.9%)	72.4%

※ 当期純利益は親会社株主に帰属する当期純利益



株主還元

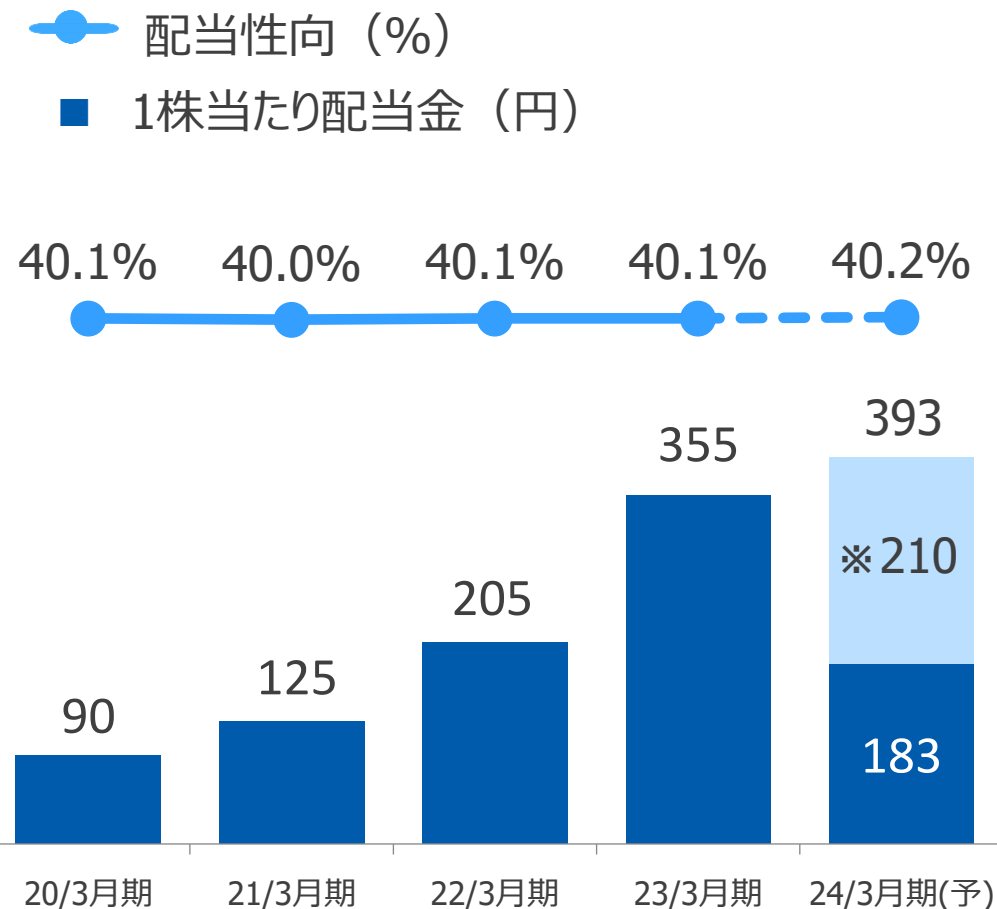
1株当たり配当金

(円)

	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年3月期 (分割考慮無し)	
			期初予定	10/31時点
中間	105	145	140	183
期末	100	210	210 (※ 70)	210 (※ 70)
合計	205	355	350	393

※ 2023年10月1日付で 1株につき3株の割合で
株式分割を実施

配当金・配当性向



※ 株式分割を考慮しない場合の配当金額で記載

配当政策

- 配当性向 40%
- 安定的・継続的な配当



本資料に関する注意事項

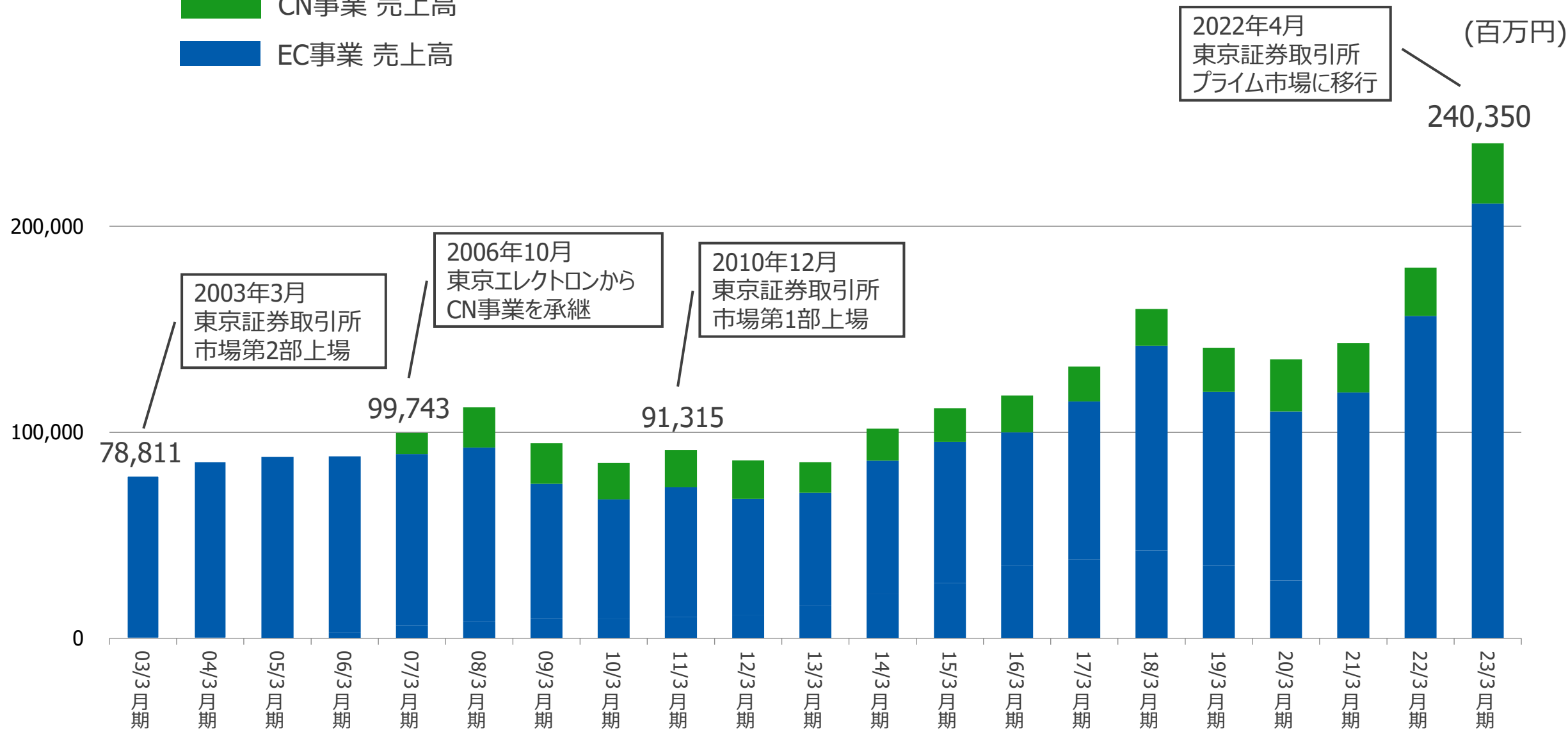
本資料で述べられている将来に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに構築されたものです。当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な要因により、今後の業績見通しが本資料と異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。

また、大きな変更がある場合は、その都度発表していく所存です。

本資料に掲載された会社名、製品名、サービス名ならびにロゴは、各社の商標または登録商標です。

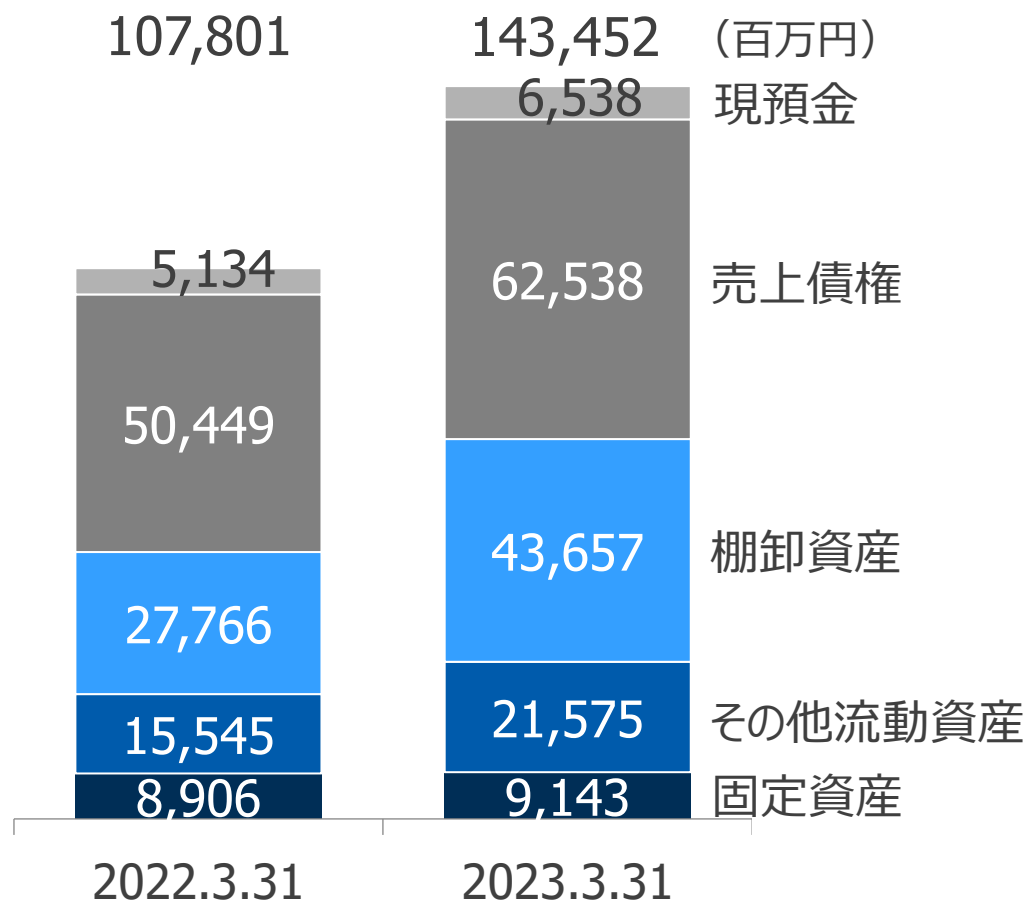
参考資料：連結業績推移

■ CN事業 売上高
■ EC事業 売上高

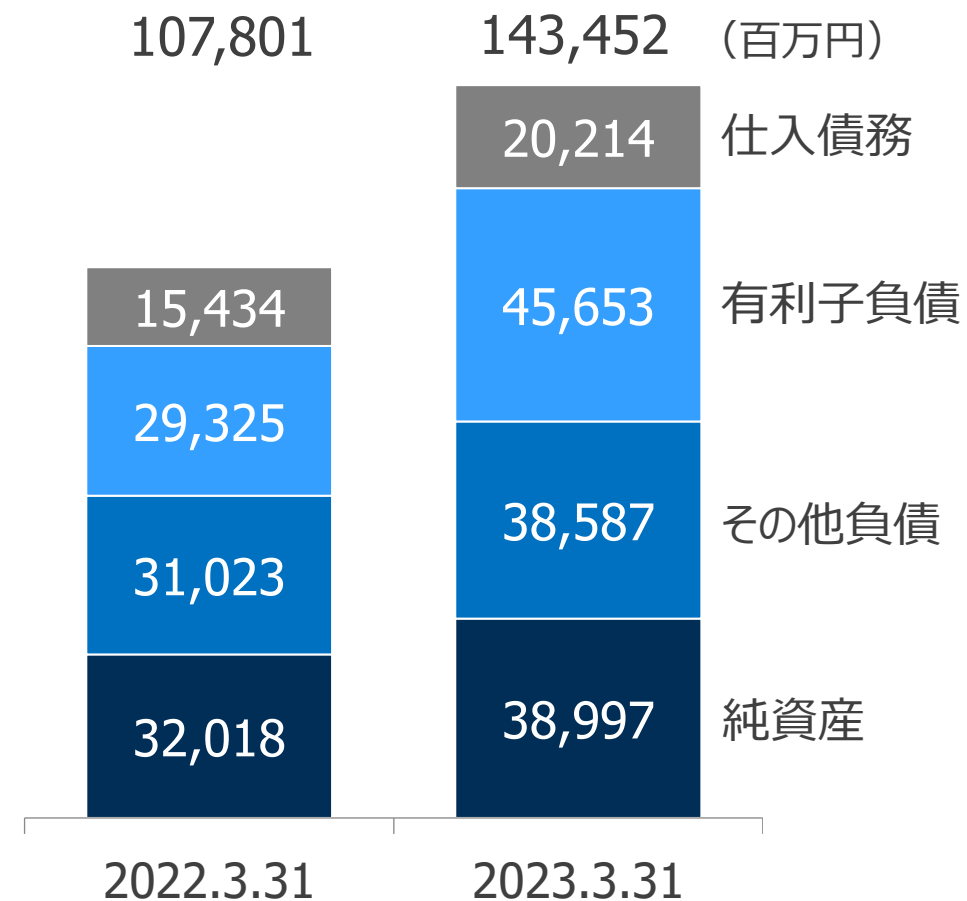


参考資料：連結貸借対照表

資産

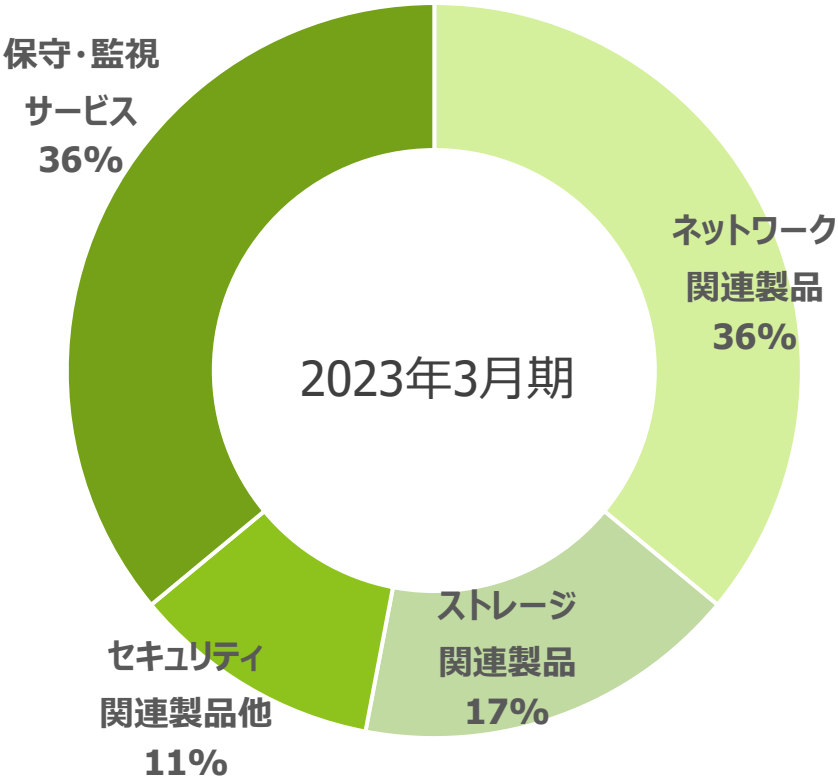


負債・純資産



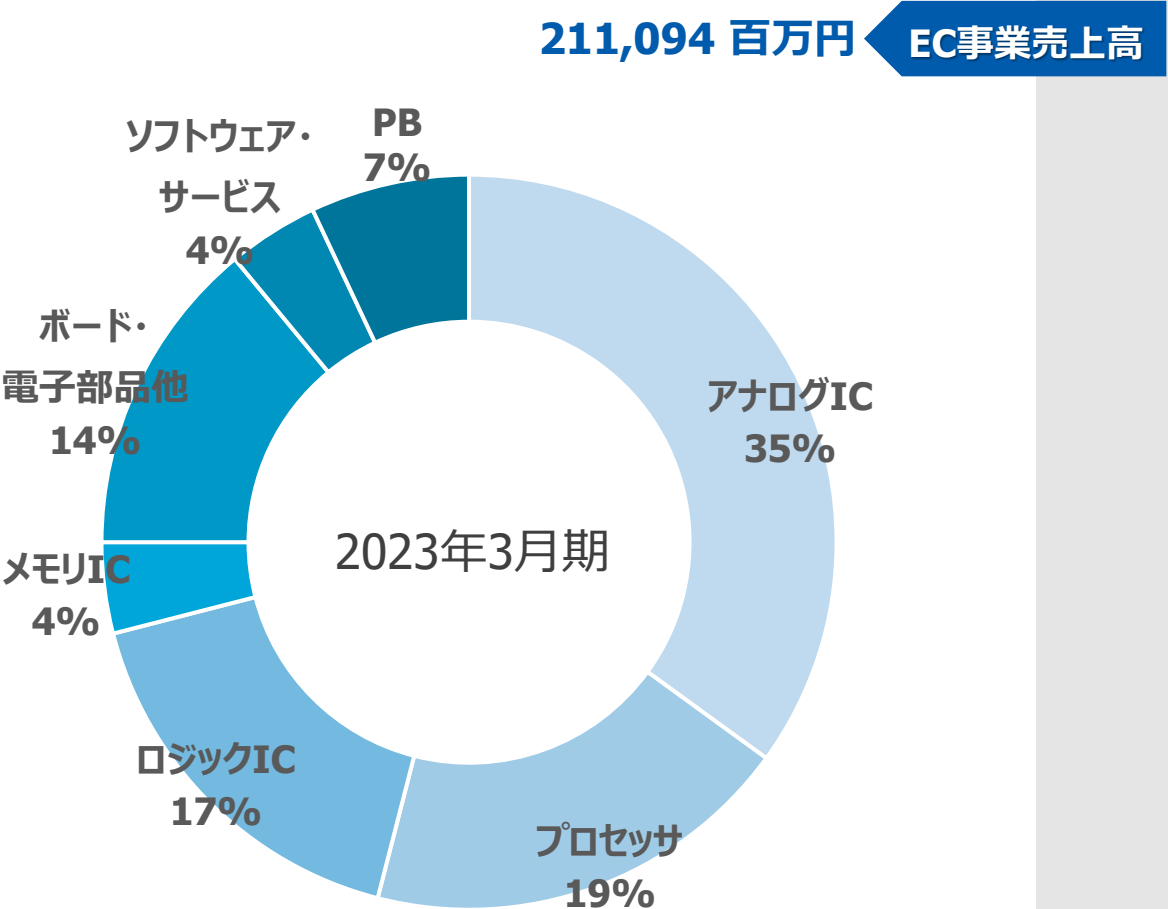
ソリューション	主な製品
ネットワーク 関連製品	ネットワーク負荷分散装置 イーサネットスイッチ
ストレージ 関連製品	フラッシュストレージ
セキュリティ 関連製品	エンドポイント ネットワーク クラウド
保守・監視 サービス	機器保守サービス セキュリティ監視サービス

29,255 百万円 CN事業売上高

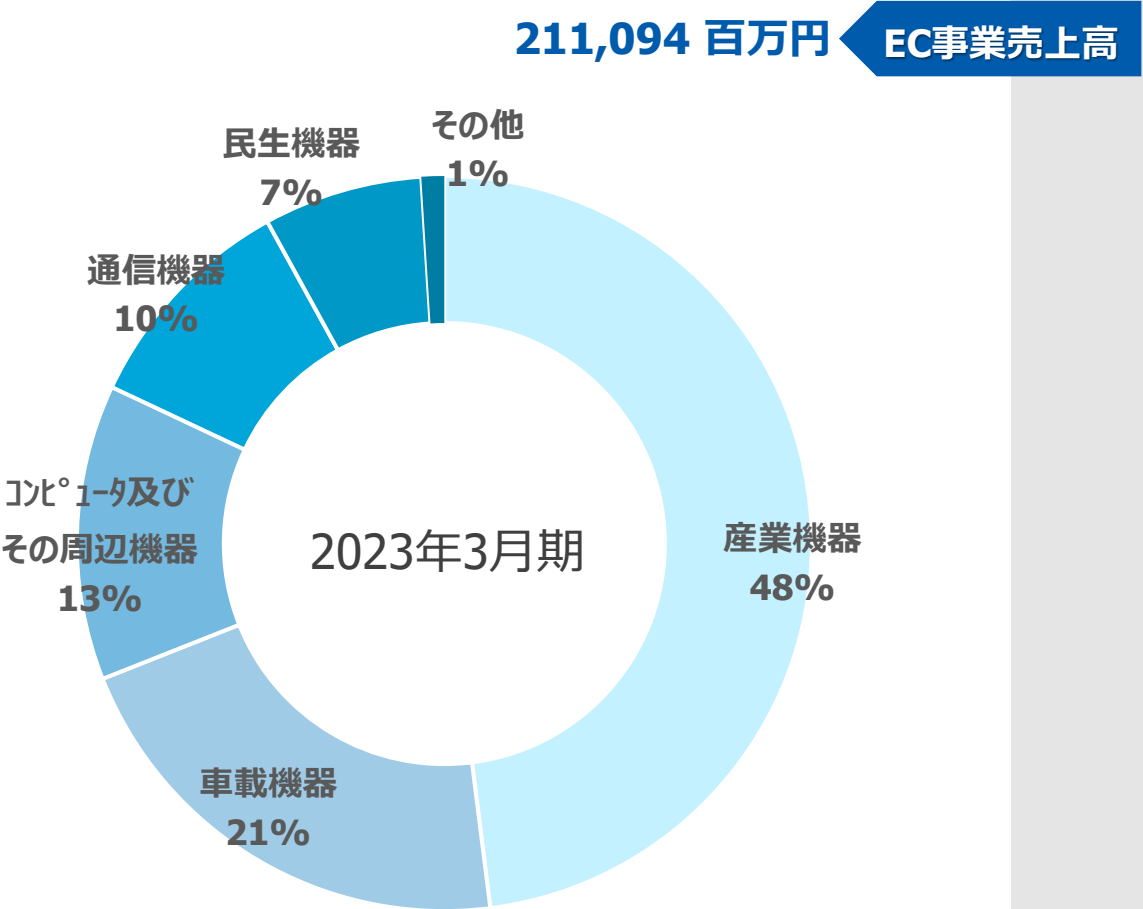


参考資料：EC事業 品目別売上構成比

品 目	主な商品
アナログIC	アナログIC
プロセッサ	CPU DSP
ロジックIC	画像処理用IC 通信・ネットワーク用IC ASIC PLD
メモリIC	SRAM / FRAM / MRAM フラッシュメモリ
ボード・ 電子部品他	ボード / 電源 / 光学部品
ソフトウェア・ サービス	ソフトウェア クラウドサービス
PB	設計・量産受託サービス 自社ブランド製品

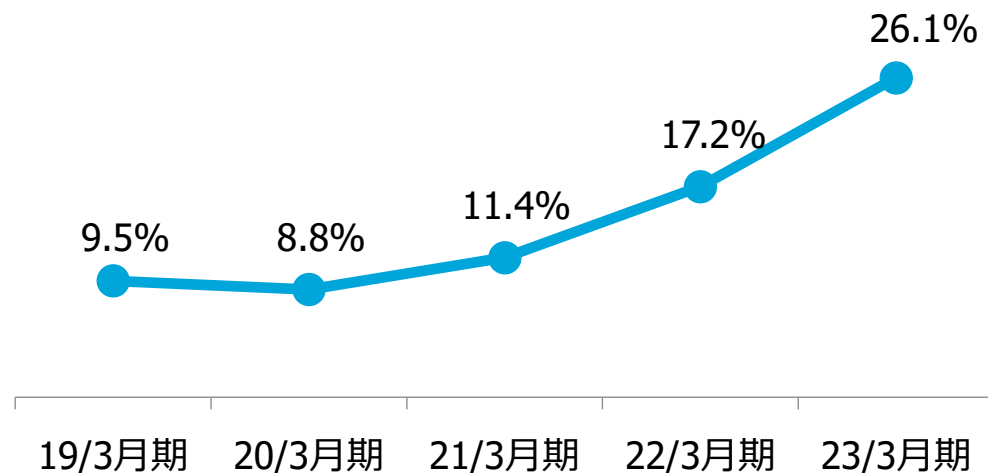


用 途	主な商品
産業機器	医療機器・分析装置 / FA機器 半導体製造装置 / 加工機 / 計測器 工業用ロボット / 制御システム インバータ / 電子部品実装関連装置
車載機器	カーナビゲーション / 車載計器 先進運転支援システム ディスプレイ / 車載用インバータ 車載ECU（電子制御ユニット） リチウムイオンバッテリー
コンピュータ及び その周辺機器	複合プリンタ / POSシステム ストレージ・サーバー プロジェクタ / PC及び付属機器
通信機器	5G基地局 / 光伝送装置 衛星通信機器 ワイヤレスIPネットワーク機器
民生機器	電子楽器 / 家庭用ゲーム機 デジタルカメラ / エアコン / TV・HDDレコーダ / 家庭用燃料電池

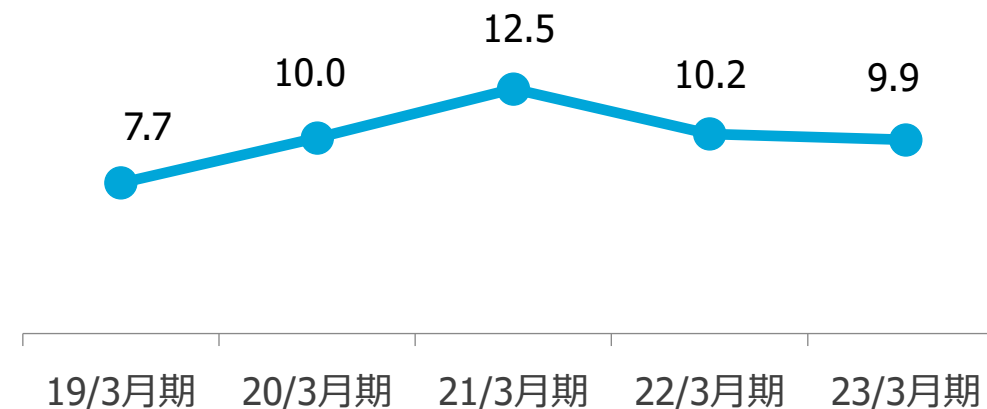


参考資料：経営指標

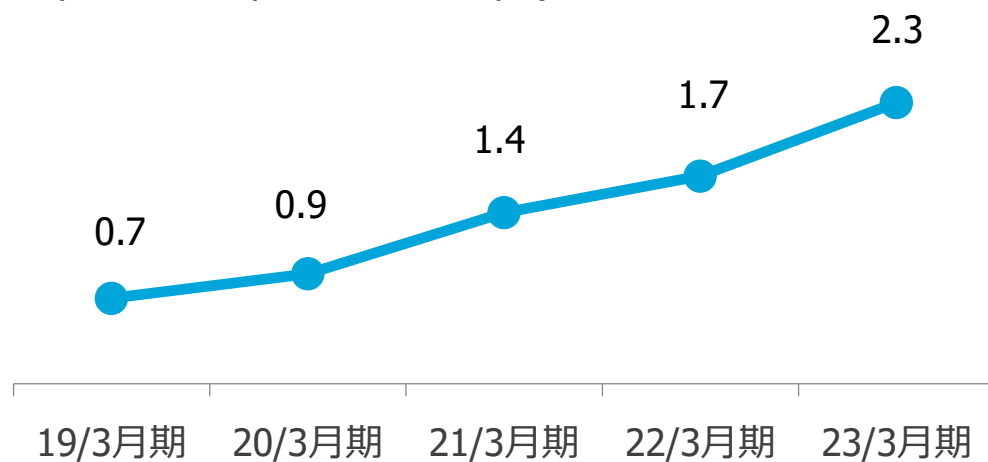
株主資本当期純利益率 ROE (%)



株価収益率 PER (倍)



株価純資産倍率 PBR (倍)



- ※株主資本当期純利益率 (ROE) = 親会社株主に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均株主資本
- ※株価収益率 (PER) = 期末株価 ÷ 一株当たり当期純利益
- ※株価純資産倍率 (PBR) = 期末株価 ÷ 一株当たり純資産

国内の主な専門商社

エレクトロニクス

証券コード	社名	証券コード	社名
2715	エレマテック	8081	カナデン
2737	トーメンデバイス	8084	菱電商事
3132	マクニカホールディングス	8137	サンワテクノス
3156	レスターホールディングス	8140	リョーサン
7433	伯東	8141	新光商事
7467	萩原電気ホールディングス	8150	三信電気
7510	たけびし	8154	加賀電子
7537	丸文	8159	立花エレテック

情報サービス

証券コード	社名	証券コード	社名
1973	NECネットエスアイ	4832	JFEシステムズ
2327	日鉄ソリューションズ	7518	ネットワンシステムズ
3132	マクニカホールディングス	8056	BIPROGY
3762	テクマトリックス	9719	SCSK

本社移転

- 2024年10月 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワーに移転予定
- 新たな価値創造が加速するコミュニケーションセンターへ



＜ビル完成イメージ＞